Bohren von flexiblen Formen, Sack- und Lochbohrungen, Schneiden, In- und Aufglasmarkierungen, Strukturieren, Abtragen von Beschichtungen – Die All-In-One Lösung von MDI Advanced Processing GmbH

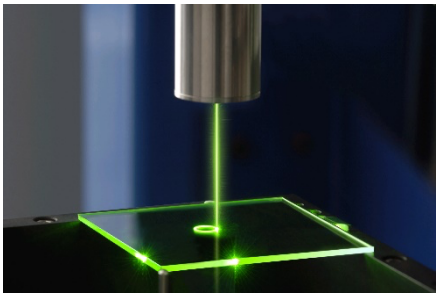
LD 500: Glasbearbeitung für kleine Substrate

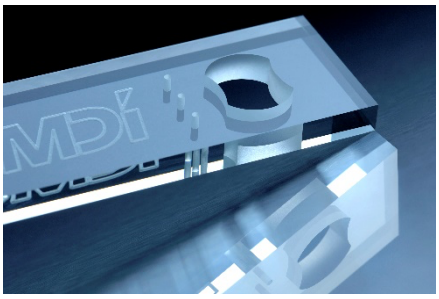


Die Glasbearbeitungsanlagen der LD Serie von **MDI Advanced Processing GmbH** bieten aufgrund der eingesetzten Lasertechnologie (532nm) eine qualitativ hochwertige Bearbeitung von spröden Materialien für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.

Technologie und Prozess

Der "Grüne Laser" ermöglicht Bohren von flexiblen Formen, Sack- und Lochbohrungen, Schneiden, Markierungen in und auf dem Glas, Strukturieren sowie Abtragen von Beschichtungen in einer Anlage. Der Prozess basiert auf einem Festkörperlaser, der grünes Licht mit einer Wellenlänge von 532 nm emittiert, höchste Präzision für Ihre Applikation.





Technische Daten

- Substratgröße: max. 500 x 500 mm
- Glasdicke: 0.3 – 200 mm
- Positionierungs- / Wiederholgenauigkeit: ± 0.1 mm / ± 0.05 mm
- Maschinenabmessung (L x B x H): min. 1.800 x 1.400 x 2.100 mm

Optionen

- kundenspezifische Anpassungen
- verschiedene Tischformen und Spannsysteme
- Programmiersoftware (DXF-Konverter)

Gerne informiert **MDI Advanced Processing GmbH** Sie detailliert über die LD-Serie und zeigt Ihnen die Vorteile für Ihr Unternehmen auf.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben oder an einer Live-Demonstration unserer Technologien und Produkte interessiert sind.

MDI Advanced Processing GmbH
Obere Austrasse 6
55120 Mainz
Germany
Phone: +49 (0) 61 31 / 73 21-0
Fax: +49 (0) 61 31 / 73 21-101
E-mail: sales@mdi-ap.com
www.mdi-ap.com

MDI Advanced Processing GmbH

Bohren von flexiblen Formen, Sack- und Lochbohrungen, Schneiden, In- und Aufglasmarkierungen, Strukturieren, Abtragen von Beschichtungen – Die All-In-One Lösung von MDI Advanced Processing GmbH

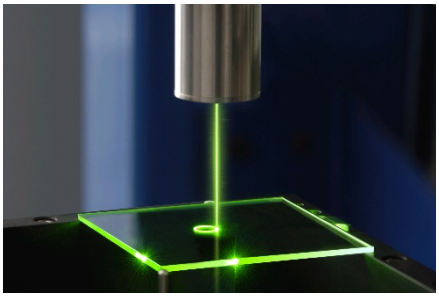
LD 650: Glasbearbeitung für mittlere Substrate

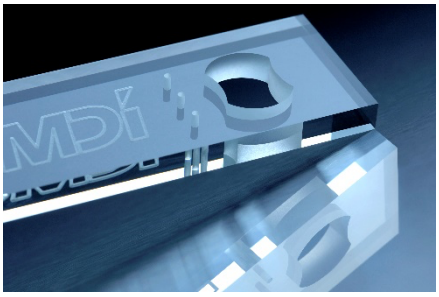


Die Glasbearbeitungsanlagen der LD Serie von **MDI Advanced Processing GmbH** bieten aufgrund der eingesetzten Lasertechnologie (532nm) eine qualitativ hochwertige Bearbeitung von spröden Materialien für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.

Technologie und Prozess

Der "Grüne Laser" ermöglicht Bohren von flexiblen Formen, Sack- und Lochbohrungen, Schneiden, Markierungen in und auf dem Glas, Strukturieren sowie Abtragen von Beschichtungen in einer Anlage. Der Prozess basiert auf einem Festkörperlaser, der grünes Licht mit einer Wellenlänge von 532 nm emittiert, höchste Präzision für Ihre Applikation.





Technische Daten

- Substratgröße: max. 950 x 650 mm
- Glasdicke: 0.3 – 200 mm
- Positionierungs- / Wiederholgenauigkeit: ± 0.05 mm / ± 0.25 mm
- Maschinenabmessung (L x B x H): min. 2.800 x 1.900 x 2.100 mm

Optionen

- kundenspezifische Anpassungen
- verschiedene Tischformen und Spannsysteme
- Programmiersoftware (DXF-Konverter)
- Alignment System
- Laserleistungsmessung
- Automatisierung

Gerne informiert **MDI Advanced Processing GmbH** Sie detailliert über die LD-Serie und zeigt Ihnen die Vorteile für Ihr Unternehmen auf.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben oder an einer Live-Demonstration unserer Technologien und Produkte interessiert sind.

MDI Advanced Processing GmbH
Obere Austrasse 6
55120 Mainz
Germany
Phone: +49 (0) 61 31 / 73 21-0
Fax: +49 (0) 61 31 / 73 21-101
E-mail: sales@mdi-ap.com
www.mdi-ap.com

MDI Advanced Processing GmbH

Bohren von flexiblen Formen, Sack- und Lochbohrungen, Schneiden, In- und Aufglasmarkierungen, Strukturieren, Abtragen von Beschichtungen – Die All-In-One Lösung von MDI Advanced Processing GmbH

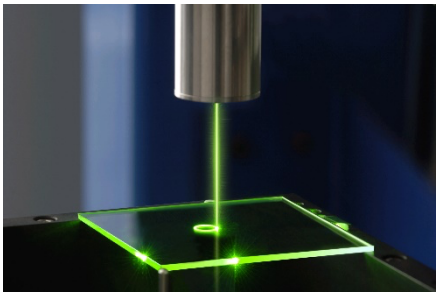
LD 2000: Glasbearbeitung für große Substrate

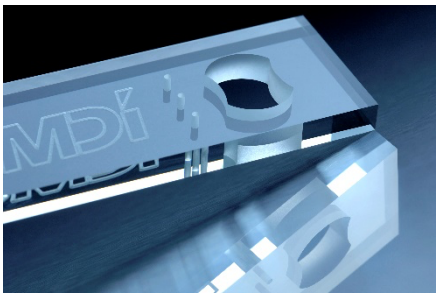


Die Glasbearbeitungsanlagen der LD Serie von **MDI Advanced Processing GmbH** bieten aufgrund der eingesetzten Lasertechnologie (532nm) eine qualitativ hochwertige Bearbeitung von spröden Materialien für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.

Technologie und Prozess

Der "Grüne Laser" ermöglicht Bohren von flexiblen Formen, Sack- und Lochbohrungen, Schneiden, Markierungen in und auf dem Glas, Strukturieren sowie Abtragen von Beschichtungen in einer Anlage. Der Prozess basiert auf einem Festkörperlaser, der grünes Licht mit einer Wellenlänge von 532 nm emittiert, höchste Präzision für Ihre Applikation.





Technische Daten

- Substratgröße: max. 2000 x 1500 mm
- Glasdicke: 0.3 – 200 mm
- Positionierungs- / Wiederholgenauigkeit: ± 0.1 mm / ± 0.05 mm
- Maschinenabmessung (L x B x H): min. 3.500 x 3.300 x 2.100 mm

Optionen

- kundenspezifische Anpassungen
- verschiedene Tischformen und Spannsysteme
- Programmiersoftware (DXF-Konverter)
- Alignment System
- Laserleistungsmessung
- Automatisierung

Gerne informiert **MDI Advanced Processing GmbH** Sie detailliert über die LD-Serie und zeigt Ihnen die Vorteile für Ihr Unternehmen auf.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben oder an einer Live-Demonstration unserer Technologien und Produkte interessiert sind.

MDI Advanced Processing GmbH
Obere Austrasse 6
55120 Mainz
Germany
Phone: +49 (0) 61 31 / 73 21-0
Fax: +49 (0) 61 31 / 73 21-101
E-mail: sales@mdi-ap.com
www.mdi-ap.com

MDI Advanced Processing GmbH